



公司简介

2026年7月

我们是科技的创新者和创造者



全球最大的垂直整合制造半导体公司之一



~49,000名员工，其中包含
~9,500名研发人员



2025年全年营收**118亿**
美元



在全球设立**80**多个营销办事处，
服务**超过20万**家客户

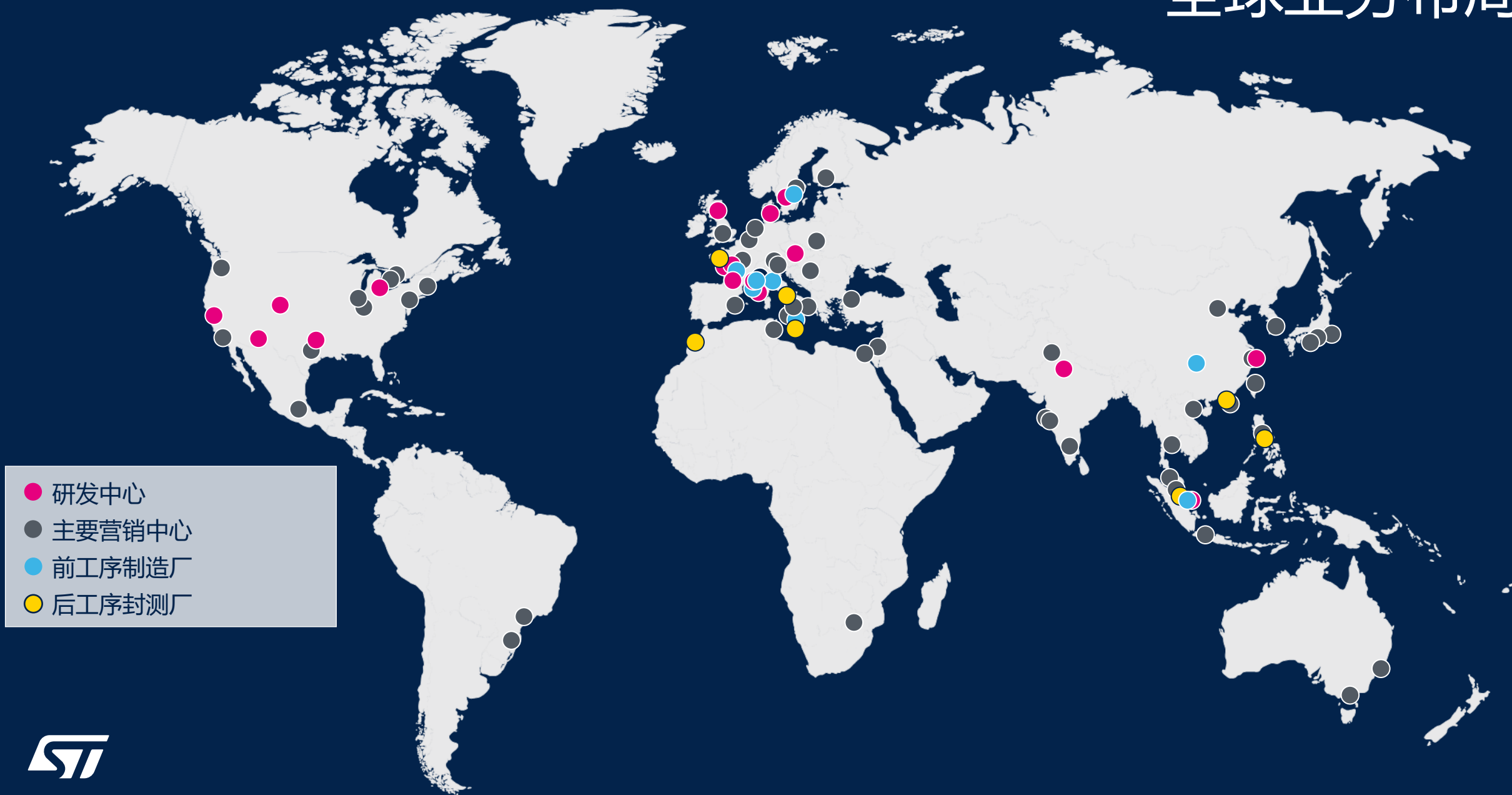


14个制造基地



联合国全球契约（UNGC）企业，负责任商业联盟（RBA）成员

全球业务布局





意法半导体 执行委员会

Jean-Marc Chery 总裁兼首席执行官



Marco Cassis

模拟、功率与分立器件、MEMS与传感器产品部 (APMS)



Remi El-Ouazzane

微控制器、数字IC与射频产品部 (MDRF)



Jerome Roux

销售 & 市场



Fabio Gualandris

质量、制造和技术



Lorenzo Grandi

总裁兼首席财务官



Steven Rose

法律顾问
& 公共事务



Rajita D'Souza

人力资源 & 企业社会责任

Mario Aleo

功率与分立器件

Vincent Fraisse

射频与光通信

Michael Anfang

EMEA & 汽车市场 & 应用*

Christophe Ayela

前端制造

Franck Freymond

审计***、企业资源管理和韧性

Stefano Cantù

企业战略规划办公室

Frédérique Le Grevès

欧洲和法国公共事务

Alexandre Balmeffre

影像

Maria Heriz

嵌入式处理

Henry Cao

中国区 & 电源/能源市场 & 应用*

Fabrice Gomez

后端制造

Giuseppe Notarnicola

资金管理

Alberto Della Chiesa

意大利董事总经理兼全球贸易合规负责人

Giuseppe Notarnicola

意大利公共事务

Simone Ferri

微机电系统 (MEMS)

Hiroshi Noguchi

APeC & 工业市场 & 应用*

Laurent Malier

全球技术研发

Bertrand Stoltz

企业财务

Chouaib Rokbi

数字转型 & 信息技术、全球采购

Bertrand Stoltz

亚太区公共事务

Rino Peruzzi

美洲区 & PE/CECP市场 & 应用*

Thomas Morgenstern

制作

Jérôme Ramel

企业发展及综合对外传播

Ricardo De-Sa-Earp

全球代理渠道整合

Nicolas Yackowlew

全球产品质量和可靠性

Claudia Levo

整合营销 & 传播

Philippe Dereeper

首席道德与合规官

*** 向监事会审计委员会主席报告，同时虚线汇报给CEO

APeC = 亚太地区 (除中国外)
PE/CECP = 个人电子产品、通信设备和计算机周边设备

* 专注终端市场的应用营销部门

我们的愿景

意法半导体主张科技引领智能生活

life.augmented

在任何对提升人类生活品质有促进意义的应用领域，只要有微电子，就有意法半导体。

我们的价值主张

为股东创造价值



回报价值与我们的目标保持一致

符合可持续发展原则且盈利的发展目标



为客户创造价值



以差异化赋能

独立、可靠、安全的供应链

为利益相关方创造价值



坚持可持续发展原则

我们的价值观：
保持诚信、以人为本、追求卓越

我们的科技始之于你

意法半导体，科技始之于

你

我们的
员工

我们的
客户

我们的
合作伙伴

应用场景



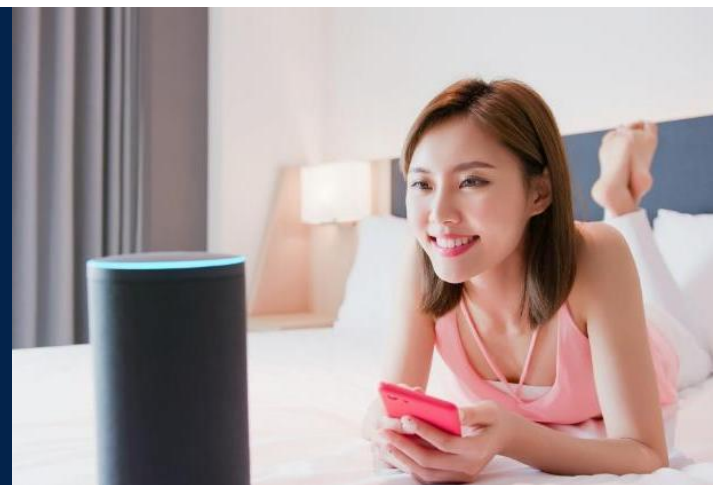
让**驾驶**变得
更安全, 更环保,
更智联

让**工业**向更智能、
更安全、更高效的
工厂和工作场所发展

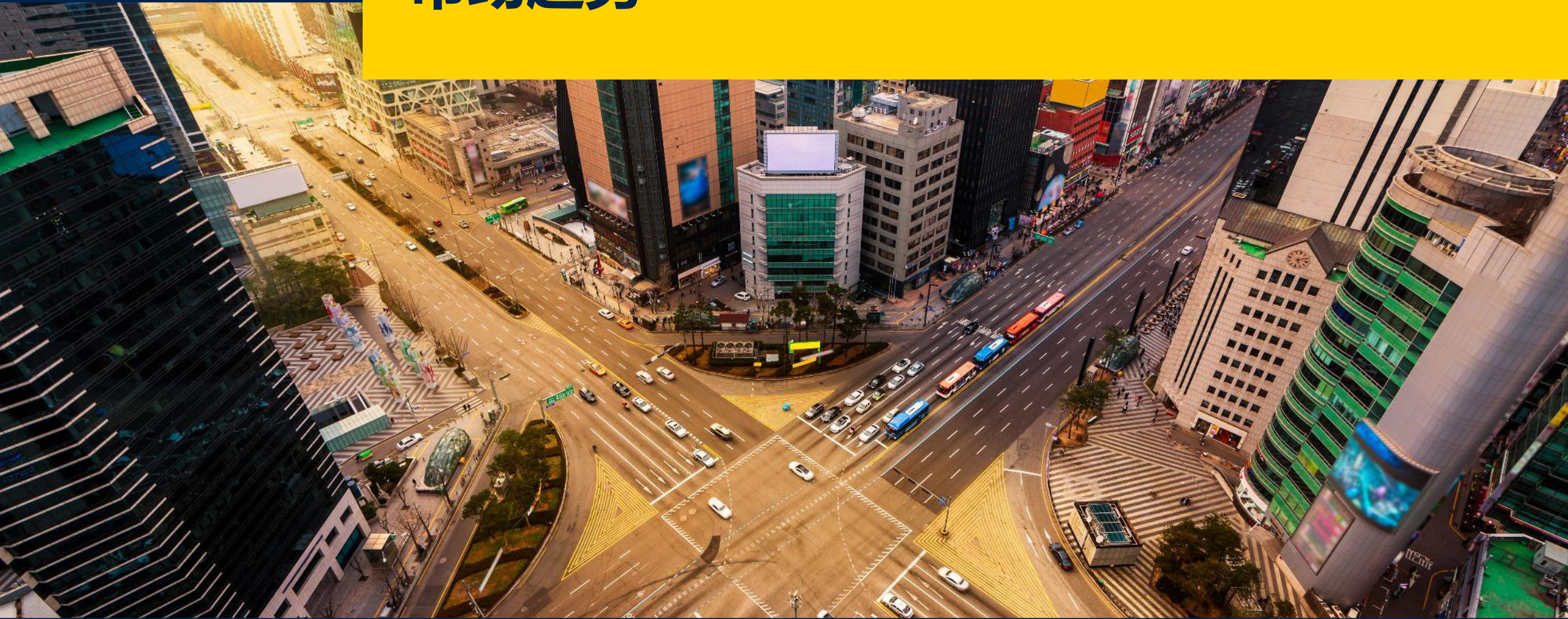


让**家居和城市**变得更智
能, 让生活更美好, 更
安全, 更好地利用现有
资源

让**日常设备**变得
更智能, 更智联, 富有
更强的情景感知能力



市场趋势



我们的战略源于几个关键的长期赋能趋势

智能出行



帮助车企为人们打造更安全、
更环保、更智联的汽车

电源 & 能源



帮助各行各业全方位提高能效
和可再生能源利用率

云连接的自主化设备



我们支持基于边缘人工智能的、安全且互联
的自主化设备发展和普及

ST创新方案帮助客户将驾驶变得更安全、更环保、更智联

提高道路使用者的安全，
提升驾驶舒适性和便利性

道路交通事故每年造成大量人员伤亡，
经济损失>**5,000亿美元**

打造价格合理、
令人满意的电动汽车

电动汽车占汽车销量的比例将在2030
年增至~40%

打造更清洁、更环保的
内燃机 (ICE)

2026-2030年，~**75%**的新车
采用内燃机

电源 & 能源

ST技术方案让客户能够全方位提高能效，并支持再生能源利用

电力需求和用电量都在增长

到2027年，全球能源需求将增长2倍

增加再生能源的利用率

到2026年，太阳能与风能发电量在全球总发电量中的占比预计将突破**19%**

减少碳排放量，降低全球温室效应

为在2030年前将全球变暖幅度控制在1.5°C以内，温室气体排放量需比2019年水平减少**43%**

云连接的自主化设备

支持基于边缘人工智能的、安全且互联的自主化设备发展和普及

云连接和由数据驱动的相关服务

到2030年，物联网连接设备将突破**400亿台**

保护所有数据的数字安全技术

到2030年，全球物联网安全市场规模预计将增至**约1400亿美元**

边缘人工智能的快速发展

到2035年，预计全球**74%**的数据将在本地完成处理

我们的战略



我们专注四大终端市场



汽车



工业



个人电子设备



通信、计算机及周边设备



我们的战略目标

汽车



致力于成为**汽车电
动化**的领导者



致力于成为**汽车数
字化**的领导者

工业



致力于成为**嵌入式处
理技术**的领导者



扩大**电源&能源管理**
业务



成为**传感器**市场的领
导者



加快在**模拟器件**市场
上的发展

个人电子设备



凭借差异化产品或定制
解决方案，在**特定**的大
规模**智能手机**应用领域，
致力于成为市场领导者



利用**广泛的产品组合**来
满足大规模应用领域
的需求

通信、计算机及周边设备

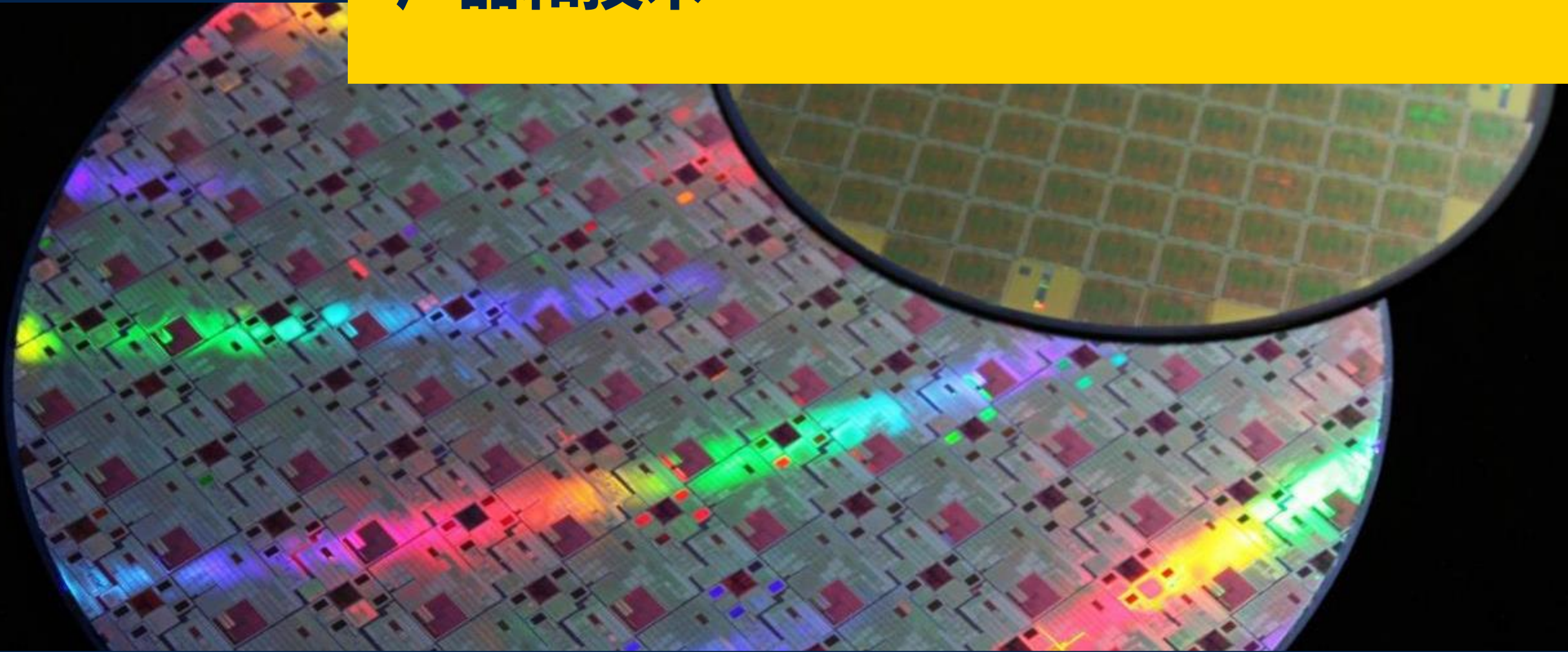


通过差异化的产品或定制
解决方案满足**特定**的大规
模**应用领域**的需求

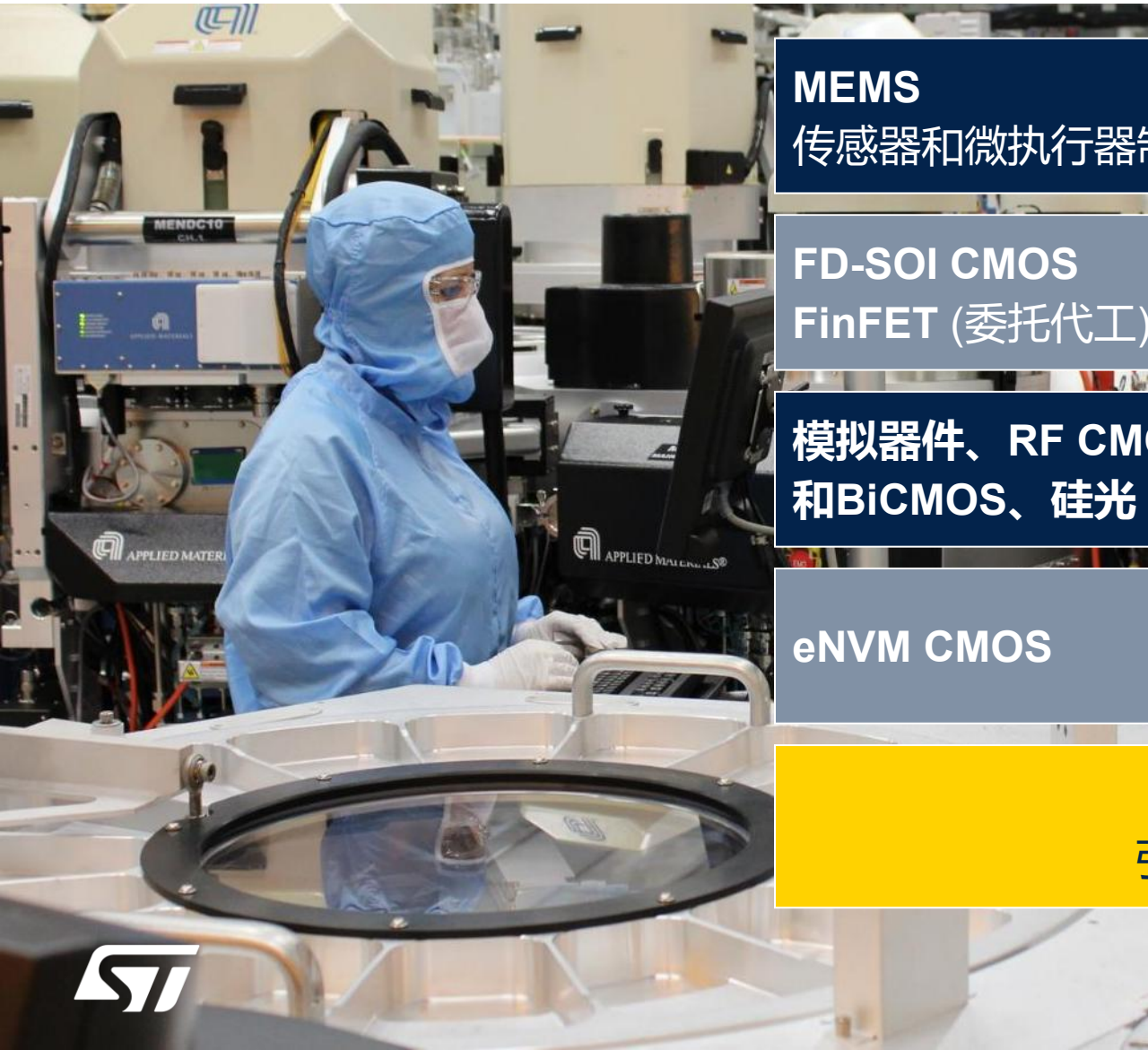


利用**广泛的产品组合**来满
足大规模应用领域的需求

产品和技术



差异化技术是我们的基石



MEMS

传感器和微执行器制造技术

智能功率: BCD

(双极 - CMOS – 功率 DMOS)

FD-SOI CMOS

FinFET (委托代工)

**分立器件、功率MOSFET、IGBT
碳化硅、氮化镓**

**模拟器件、RF CMOS
和BiCMOS、硅光**

垂直智能功率

eNVM CMOS

光学传感解决方案

封装技术

引线框 – 层压板 – 传感器模块 – 晶圆级

我们的产品及方案为客户创新赋能

专用汽车IC



模拟器件, 工业 & 电源转换IC



通用 MCU & MPU, 无线MCU, 安全MCU, EEPROM存储器



分立器件 & 功率晶体管



MEMS & 光学传感解决方案



采用ST独有技术的ASIC专用芯片



汽车专用IC

汽车MCU



- 可扩展的单核和多核MCU解决方案
- 面向从成本敏感到先进高端的所有应用
- 支持下一代架构和多合一功能
- 完善的开发生态系统

ADAS先进驾驶解决方案



- 图像信号处理器
- 雷达收发器
- V2X车物通信解决方案
- 汽车CMOS图像传感器
- 汽车惯性传感器

信息娱乐与车联网



- 高音响保真度和导航定位精度，在任何情况下都有出色表现
- 汽车与智能手机安全互联
- 汽车与多种外围设备安全互连

汽车模拟器件和功率芯片



- 电池管理、牵引、制动、安全气囊、车门区域、发动机、电源管理集成电路 (PMIC) 的解决方案
- VIPower* 智能功率开关、高低边驱动
- LED 驱动器
- 汽车级功率分立器件
- 整套的系统解决方案

分立器件 & 功率晶体管

汽车电动化、电源管理、电机控制用主要功率技术和封装：



- 高低压硅基功率MOSFET (STripFET*, Planar & MDMESH*)
- IGBT双极晶体管
- 碳化硅MOSFET晶体管
- 氮化镓 (GaN) 功率晶体管和射频晶体管
- LDMOS和DMOS射频功率晶体管
- ACEPACK* 功率模块SLLIMM* 智能功率模块

二极管、整流管、可控硅 (SCR)、交流开关管

- 碳化硅 (SiC) 二极管和高压硅基二极管
- 超高速整流二极管和桥式整流二极管
- 电力肖特基二极管和场效应整流管
- 可控硅 (SCR) 和双向晶闸管
- ACS* 交流开关管

瞬态电压抑制 (TVS) 二极管 集成EMI滤波和电涌保护功能的IC

- ESD保护器件
- EOS和雷电浪涌保护器件
- 限流器
- IPAD* EMI和ESD双保护器件
- 集成无源器件



* 意法半导体或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标

模拟器件、工业芯片 & 电源转换芯片



电源管理



- AC-DC和DC-DC变换器
- MOSFET、IGBT、SiC、GaN 栅极驱动器
- 模拟和数字控制器
- 线性稳压器
- 智能功率开关
- 电隔离芯片
- 数字电源
- 智能功率氮化镓 (GaN)
- 电池管理 | 电子保险丝

电机控制



- 有刷直流电机驱动器
- 无刷直流电机驱动器
- 步进电机驱动器

模拟产品和专用芯片



- 运算放大器、比较器
- 电流检测放大器
- 滤波和信号调理
- 接口和收发器
- 复位和监控器
- 电力线通信芯片
- IO-Link芯片
- 抗辐射加固

通信连接解决方案

- 电源管理集成电路 (PMIC)、用于数据存储和服务器的前置放大器
- 用于个人设备的无线充电、触摸控制器、显示器 PMIC
- 医疗集成电路

MEMS & 光学传感器解决方案

运动传感器



- 加速度计与陀螺仪
- 惯性模块与智能传感器
- 振动计、倾角仪
- 磁力计
- T-Plus: 内嵌温度传感器的MEMS运动传感器

环境传感器



- 生物传感器 (运动 + 生物信号)
- 气压计、压力传感器
- 温度传感器
- 静电传感器
- MEMS麦克风

微执行器

- 打印头执行器
- 压电执行器
- 静电执行器
- 电磁执行器
- 电热执行器

光传感解决方案



- FlightSense* ToF接近检测和测距模块
- 3D FlightSense* ToF传感器
- BrightSense* 全局快门CMOS图像传感器
- 环境光传感器
- 微光学元件
- 定制光学解决方案

通用MCU & MPU, 安全方案 & NFC

通用32位MCU & MPU



- STM32* 32位通用微控制器 (MCU) 和32/64位微处理器 (MPU)
- Arm® Cortex® 内核
- 高性能、主流、超低功耗MCU配备图形和AI加速器
- 拥有涵盖Edge AI的广泛生态系统

无线32位MCU



- Bluetooth®低功耗芯片
- Zigbee、Thread、Matter
- Wi-Fi 模块
- Sub-1 GHz收发器、Sigfox兼容设备
LoRaWAN®技术
- STM32 DNA、RF扩展生态系统

安全方案



- 手机支付交易
- 身份验证和品牌保护
- 安全支付解决方案
- 车载互联服务

NFC & 存储器



- NFC / RFID 标签
- 动态 NFC标签
- NFC / RFID读取器
- 高性能和高读写次数 EEPROM

采用ST独有技术的ASIC专用芯片

ST三大核心竞争力让专用集成电路 (ASIC) 客户实现战略自主和产品差异化

- 先进的制造技术平台
- 全球设计资源和先进知识产权
- ST半导体垂直整合制造商 (IDM) 供应链

数字ASIC芯片

系统芯片设计，采用CMOS和FD-SOI工艺技术，可选择eNVM存储器；还可以采用FinFET制造技术(代工)

模拟&射频ASIC芯片

独有的射频和模拟芯片设计专业技术知识，采用先进的制造技术，例如，RFSOI、BiCMOS、硅光子学和毫米波

MEMS和影像ASIC芯片

专有的微加工技术，深厚的MEMS集成专业知识
定制化影像解决方案和优质代工服务

功率ASIC芯片

拥有大量的差异化制造技术，包括BCD、VIPower*、SiC、GaN和功率MOSFET

制造与研发



我们保证产品质量、交付灵活性和供应安全性



瑞典
Norrköping

法国
Crolles
Rousset
Tours
Rennes

意大利
Agrate
Catania
Marcianise



摩洛哥
Bouskoura

马耳他
Kirkop

● 前工序 (晶圆制造)
● 后工序 (封装测试)

中国
深圳

菲律宾
Calamba



马来西亚
Muar

新加坡



我们助力您的产品创新

在全球设立先进研发中心，与公司制造部门、客户和合作伙伴紧密合作

A photograph of two researchers in a cleanroom environment. They are wearing blue protective suits, hoods, and masks. One researcher is in the foreground, focused on a computer keyboard. Another researcher is visible behind them, also working. The background is slightly blurred, showing industrial equipment and yellow and black safety stripes.

~9,500多名研发和产品设计人员

~20,000项有效及申请中专利

2025年，研发资金占总营收约为17%

~200项活跃的研发合作

10+个晶圆厂实验室，推动开放式创新

~50家初创公司参与到我们的项目中



荣获全球百强创新企业称号

Top 100
Global
Innovator
2026

 Clarivate

意法半导体已连续五年、累计八次荣
登科睿唯安“全球百强创新机构”
榜单

STMicroelectronics recognized as a
Top 100 Global Innovator 2026 by Clarivate



客户与销售

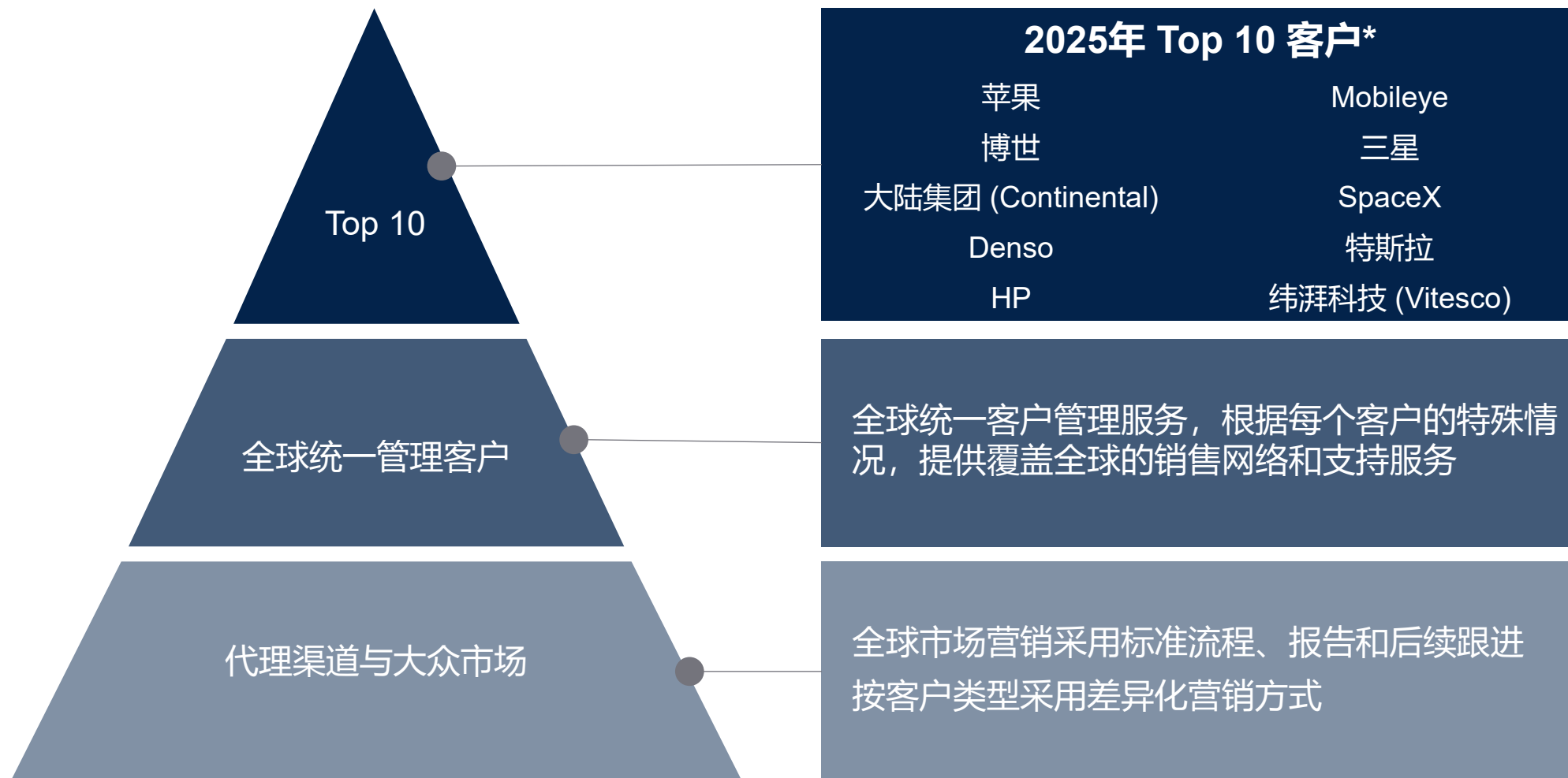


我们是全球客户的合作伙伴

在35个国家/地区设有80多个销售办事处



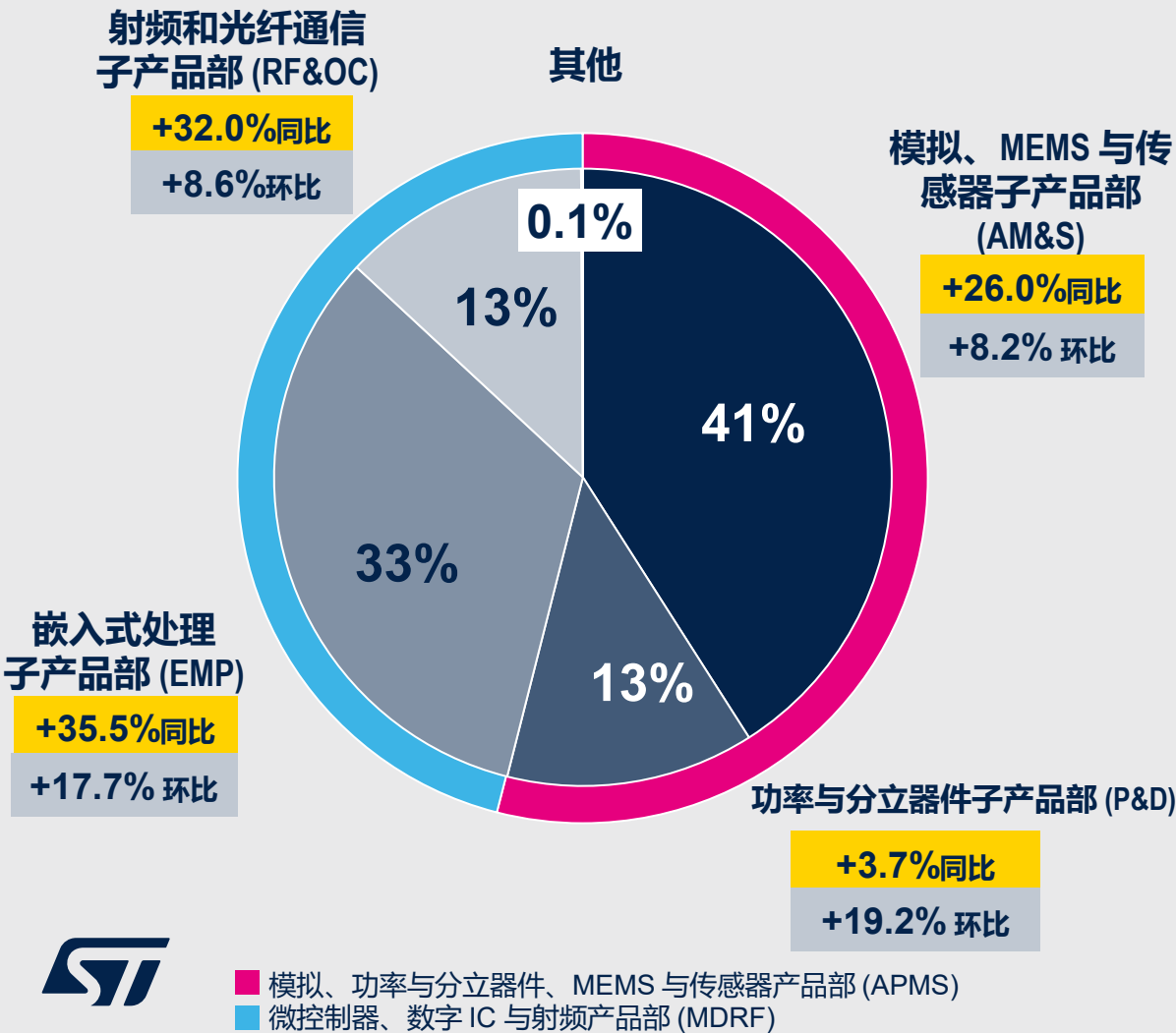
我们服务超过20万家客户



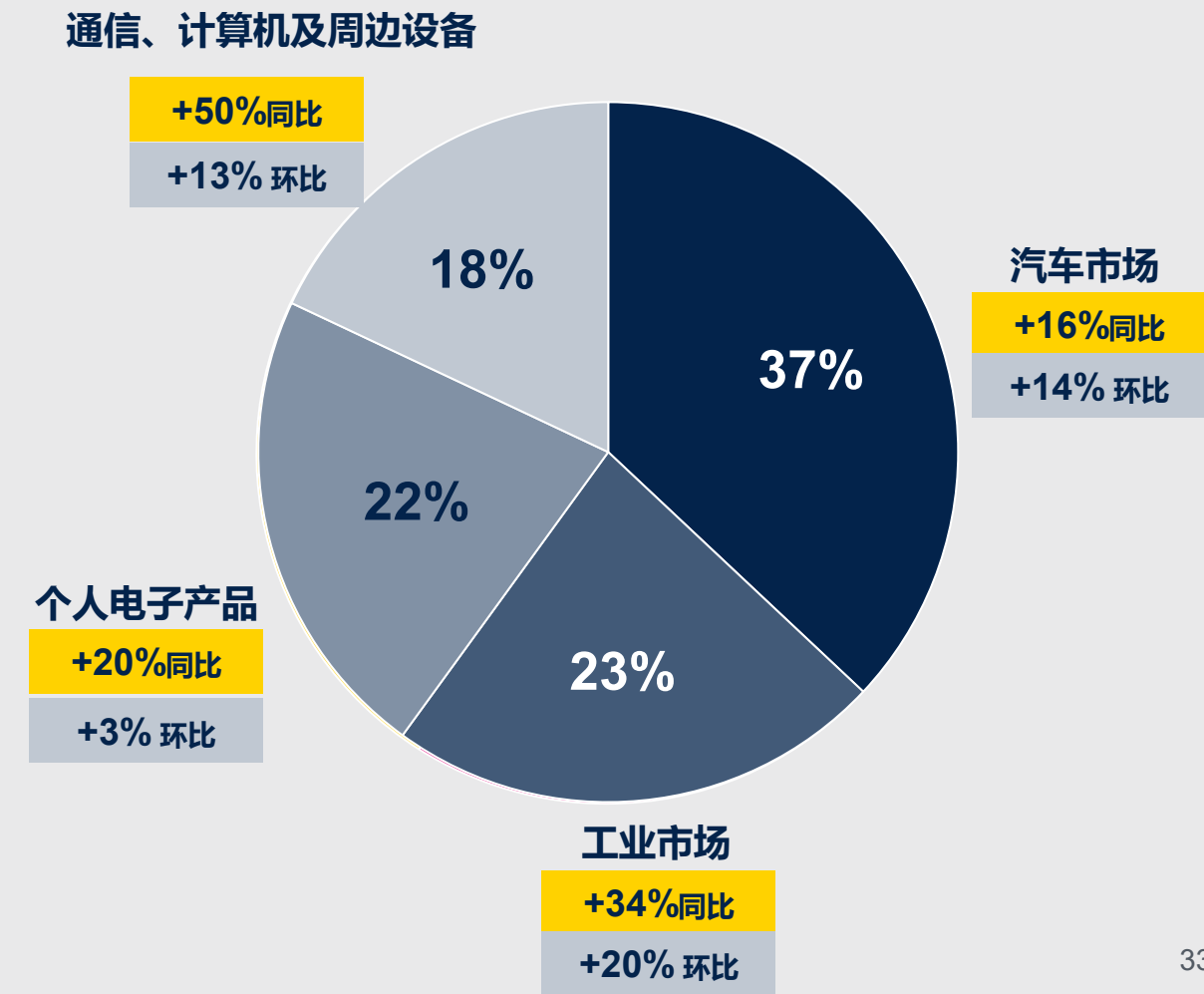
*按照英文字母顺序排列

2026年第二季度营收

产品部门收入占比%

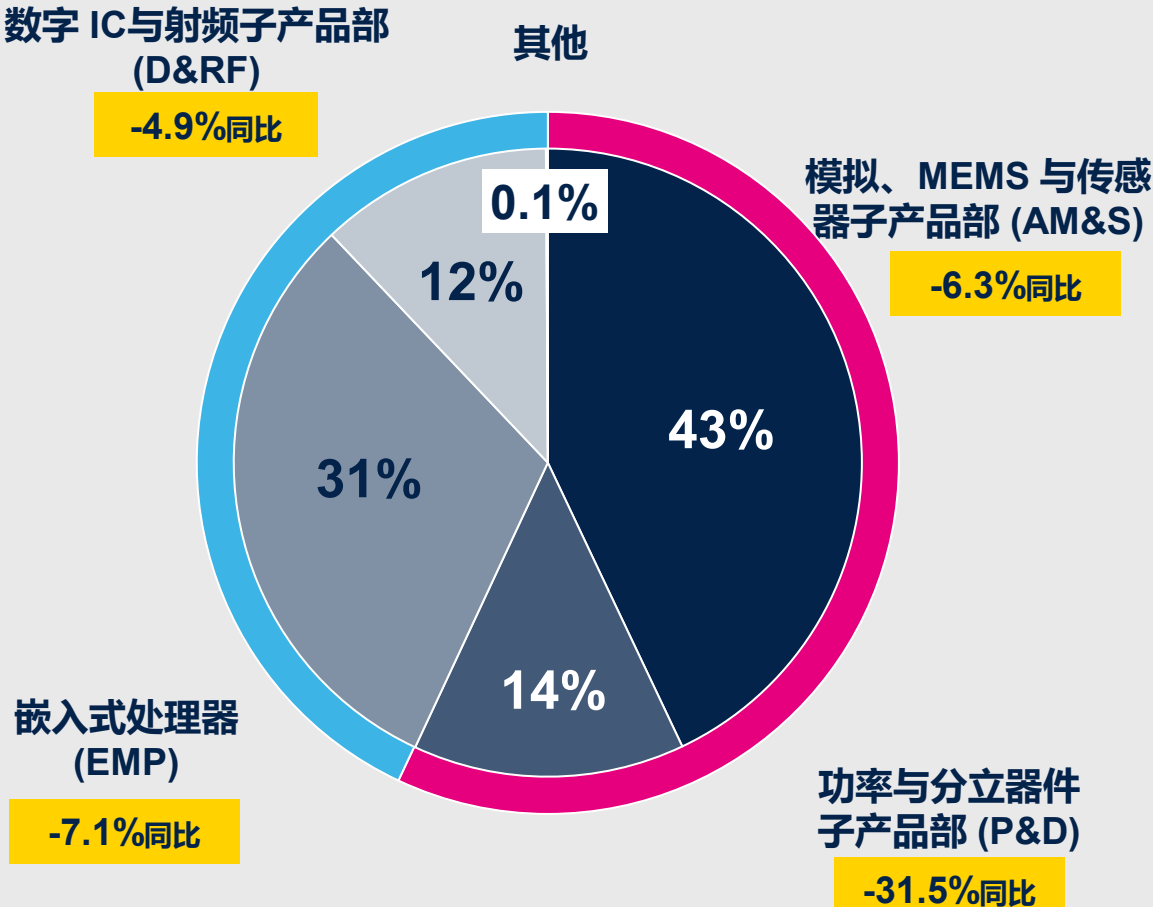


终端市场收入占比%



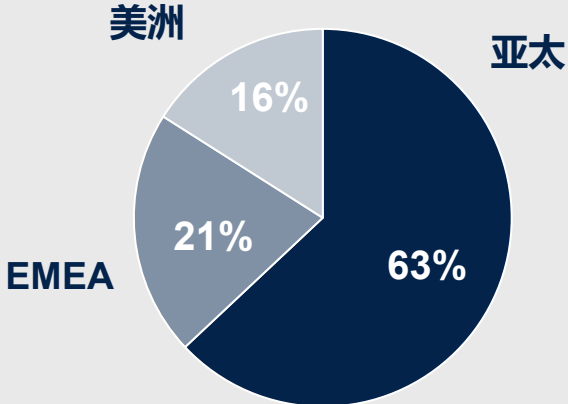
2025年全年营收

产品部门收入占比%

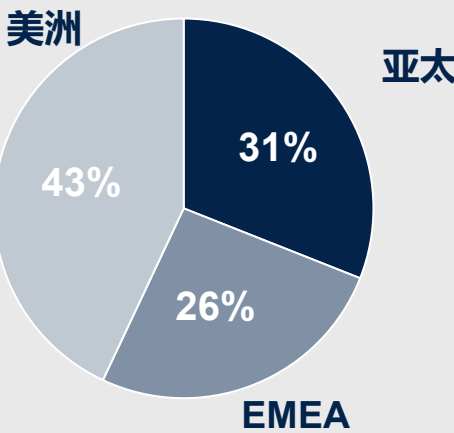


■ 模拟、功率与分立器件、MEMS 与传感器产品部 (APMS)
■ 微控制器、数字 IC 与射频产品部 (MDRF)

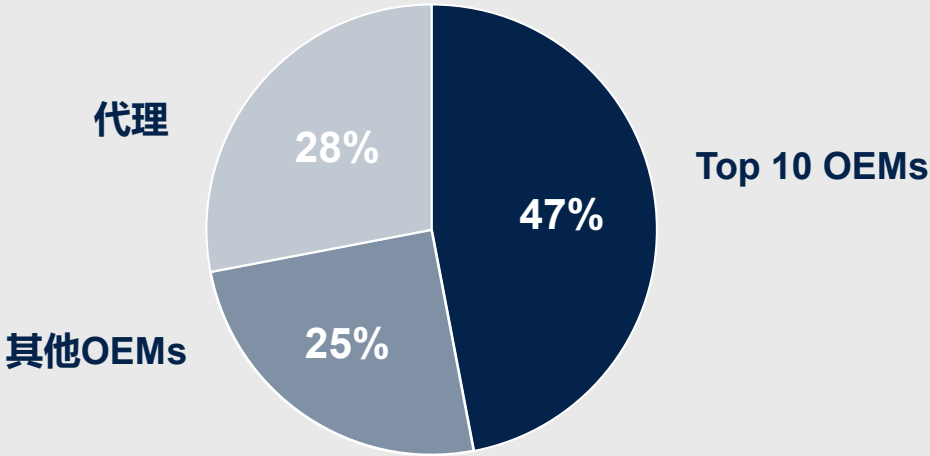
发货目的地收入占比%



原产地收入占比%



客户类型收入占比%



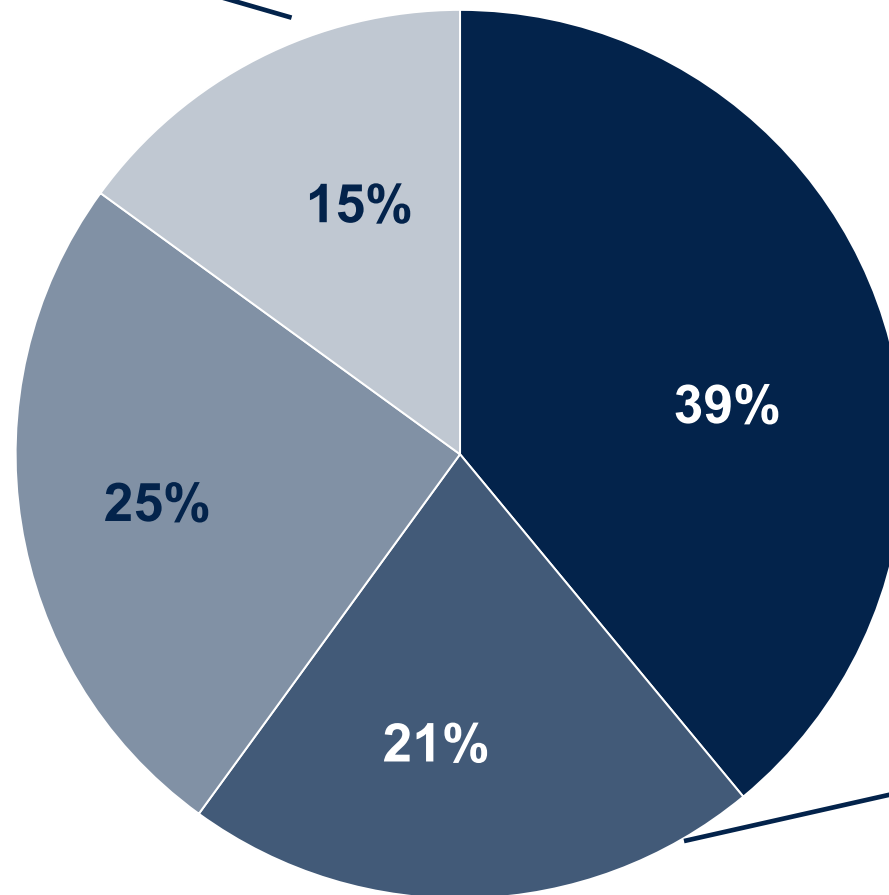
2025年终端市场营收

通信、计算机及周边设备

+5%同比

个人电子产品

+4%同比



汽车市场

-24%同比

工业市场

-7%同比

我们对质量的承诺



追求卓越质量是我们文化的重要组成部分

我们的质量文化由持续改进的承诺、预防的思维模式和为卓越的价值观而设立的STRIVE策略驱动



S	trength
T	eamwork
R	esilience
I	nnovation
V	alue
E	xpertise

更多信息请访问 www.st.com/quality

质量文化是ST的一种公司价值观

质量文化是一种内在**行为**，每位员工，无论其岗位如何，都为创造对利益相关者的**价值**贡献力量。



WE VALUE Quality

At ST, Quality is not just a goal – it is the foundation of everything we do. Our commitment is to design, develop, and manufacture reliable, high-performing, and sustainable semiconductor solutions we are proud to deliver to our customers.

Quality is everyone's responsibility, every day: we put the customer first, comply with processes and seek to improve continuously. We never ignore a challenge. We address it as an opportunity to learn and move forward together, building trust with all our stakeholders.

To stay on our path to excellence, we stand by our core values of People, Excellence, and Integrity. We put them into action by being **Bold, Agile, Smart, and Engaged**.

We power ST Quality.

STRIVE
FOR EXCELLENCE

质量是我们业务的一个主要推动力

我们的质量愿景

致力于将ST的质量提升至最高水准，
让质量成为客户的宝贵资产

我们的质量使命

确保ST的产品满足目标市场客户
对质量和可靠性的最高要求

我们的质量战略

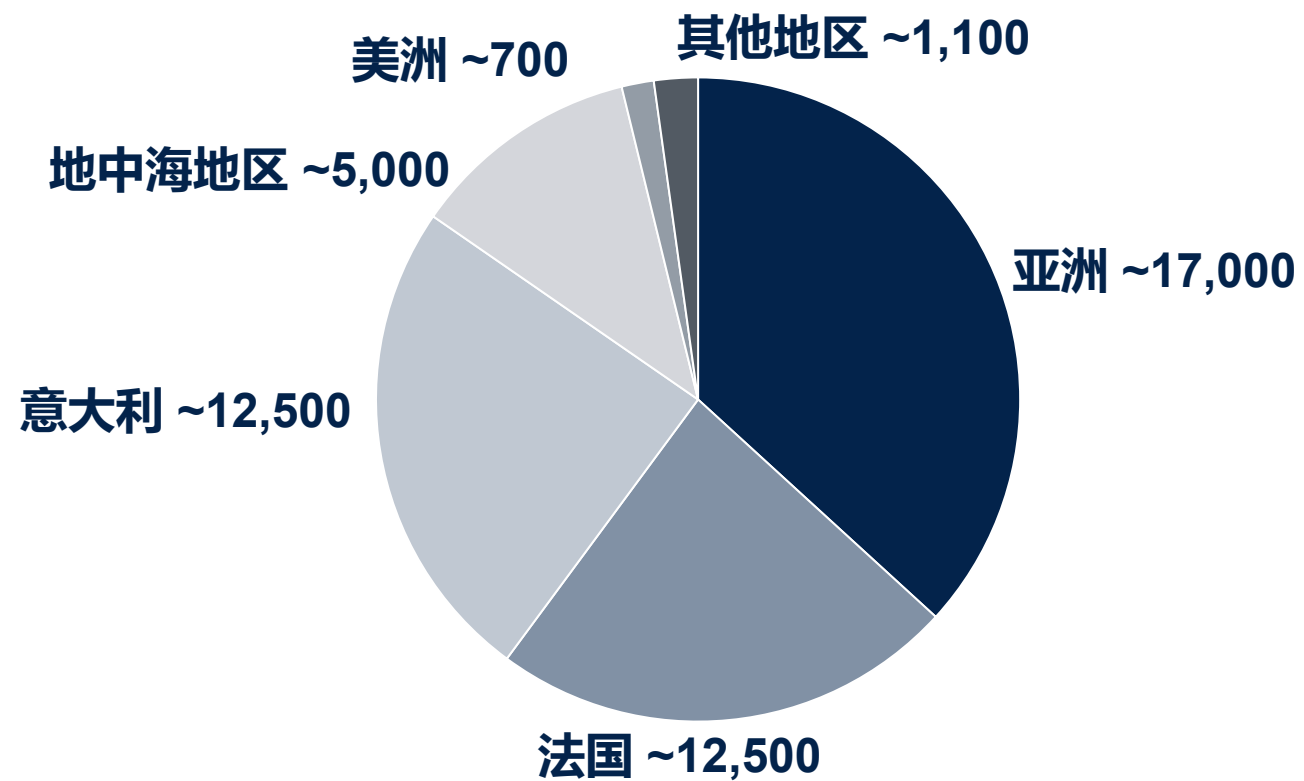
STRIVE
FOR EXCELLENCE

- 建立追求卓越质量的思维模式和企业文化
- 我们的质量目标以客户为中心
- 为先进质量和可靠性而持续创新
- 发展以结果为导向的质量改进计划

我们的员工



我们的科技以人为本



制造 ~ 62%

研发 ~ 19%

市场营销、职能部门、行政与综合服务 ~ 19%

截至2025年12月31日

意法半导体荣膺 2026 年全球杰出雇主认证



意法半导体**连续两年**荣获“全球杰出雇主”称号

系全球2026年度获此国际认证的**17家企业之一**

意法半导体在**全球41个国家**的分支机构均获该殊荣

可持续发展



30多年来，可持续发展一直铭刻在我们的商业模式和文化中



The Digital Unify Program is a multi-year initiative aimed at accelerating digital transformation across the company, focusing on the digital enablement of the organization's core business processes and the development of new digital products and services. The program is designed to drive growth, improve efficiency, and enhance the customer experience. The results of the program will be shared with stakeholders through various channels, including the company's annual report and dedicated digital transformation reports.



1987	ST 成立; 商业行为与道德政策
1993	第一版环境政策
1995	第1版环境十诫
1997	第1版环境报告, ISO 14001, EMAS
2000	全球契约组织UNGC10项原则签约企业
2001	ST Foundation成立
2002	植树造林计划
2003	OHSAS18001安全认证 (2021年迁移至ISO 45001)
2007	冲突矿产计划
2011	可持续发展科技项目
2012	ISO 50001 能源管理
2014	第5版环境、健康与安全十诫
2016	首次取得 ISO 22301业务连续性认证
2020	承诺到2027年实现碳中和*
2025	新的可持续发展目标发布
2026	第29版年度可持续发展报告 第二份综合报告 (作为意法半导体年度报告的一部分)



* 针对范围1和范围2，范围3则聚焦于产品运输、商务旅行及员工通勤产生的排放

我们的可持续发展方式

打造可持续的技术



我们为可持续发展的世界创造技术

- 设计负责任的产品和技术
- 以可持续的方式管理我们产品的生命周期
- 负责任的矿产开采
- 生态设计设备 - 节能低碳

通过可持续的方式



我们以人为本

- 确保员工的健康、安全和福利
- 树立劳工与人权榜样
- 促进多样性和包容性
- 提供出色的员工体验



我们保护环境

- 致力于碳中和*
- 先进的环境管理体系
- 减少用水量并解决当地水资源短缺风险
- 减少浪费和促进循环经济

构建可持续的公司



我们为所有利益相关者 创造长期价值

- 嵌入风险管理
- 监控和开发扩展的供应链
- 在我们所有的生态系统中推广 STEM
- 监测并透明地报告我们的进展



*STEM 即科学 (Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)、数学(Mathematics) 45

* 针对范围1和范围2，范围3则聚焦于产品运输、商务旅行及员工通勤产生的排放

我们的商业模式也影响着我们的管理方式

供应商

我们要求供应商执行**负责任的商业联盟 (RBA)** 标准，并鼓励他们完成ISO和OHSAS认证，降低在道德、社会、环境、健康和安全管理方面的风险因素。

我们参加了“**负责任的矿产倡议**”组织。

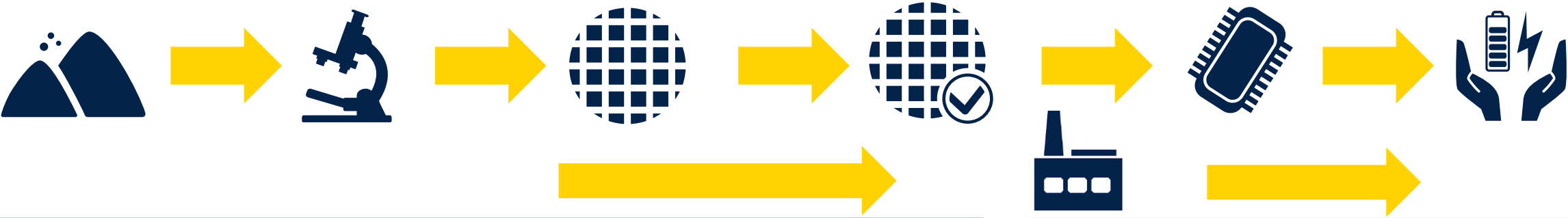
环境

我们部署了运营活动直接和间接排放**温室气体减排**计划，包括减少可长久存在于大气中并有可能导致全球变暖的全氟化合物(PFC)。

我们最大限度降低与生产过程中使用的化学物质和材料相关的**环境、健康和安全管理风险**，在物料选择、处理和替代过程中，以预防为基本原则。

我们通过二次利用和循环再用水，不断降低我们的**水足迹**，所有污水都经处理后才排放到环境中。

我们尽可能减少**垃圾**，对工业垃圾进行二次利用、循环再用或回收处理，而不是直接送到垃圾处理厂焚烧或填埋。



员工

我们通过先进的管理系统和认证计划来保障员工的**健康安全**。

我们在所有工厂执行负责任的商业联盟 (RBA) **行为准则**，降低道德、劳工和人权风险，并对所有工厂定期认证、考评和审核。

产品

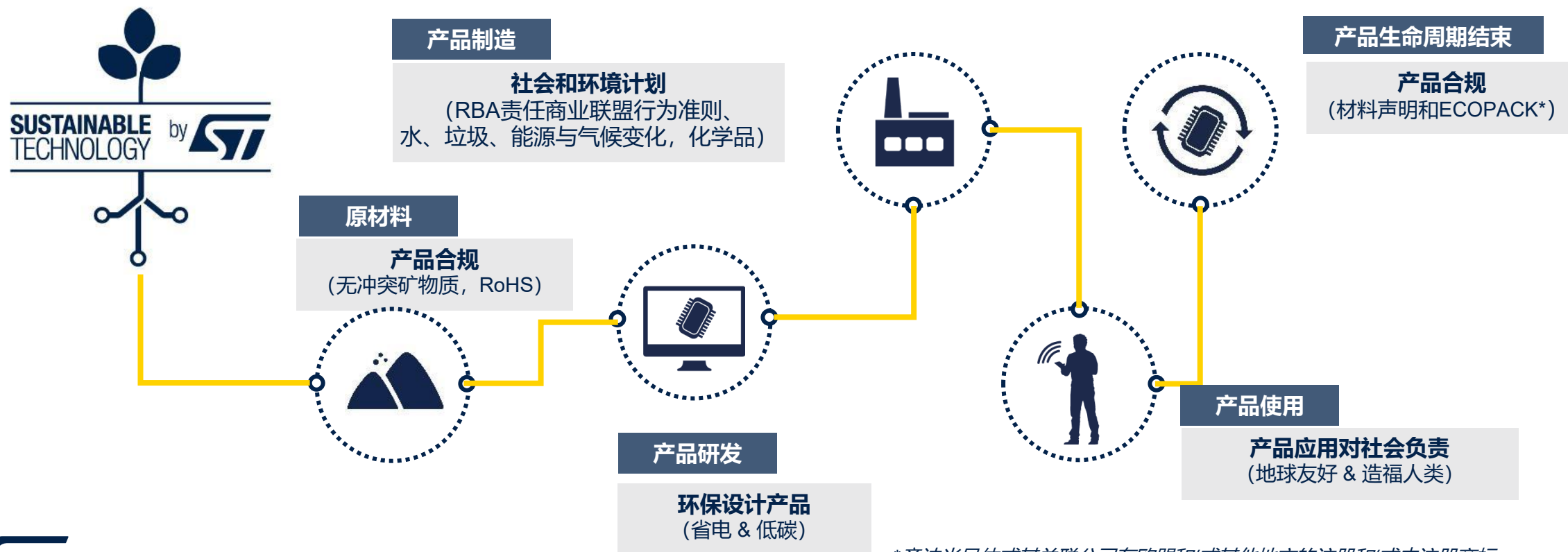
通过我们的**可持续技术计划**，我们在设计产品时系统地考虑产品在从原材料、运输、制造到使用和寿命终止的整个生命周期中对环境的影响。



可持续技术

我们的**可持续技术计划**旨在开发负责任的产品，包括：

- 在产品生命周期的每个阶段，改善我们产品的**社会和环境足迹**
- 在产品的终端应用中，对地球和人类产生**积极影响**

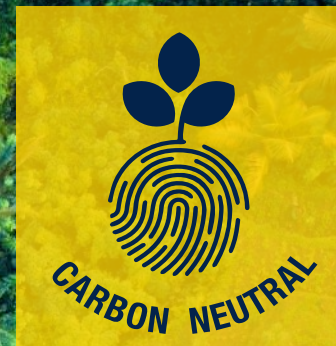


意法半导体宣布将在公司40周年之际实现碳中和目标

里程碑

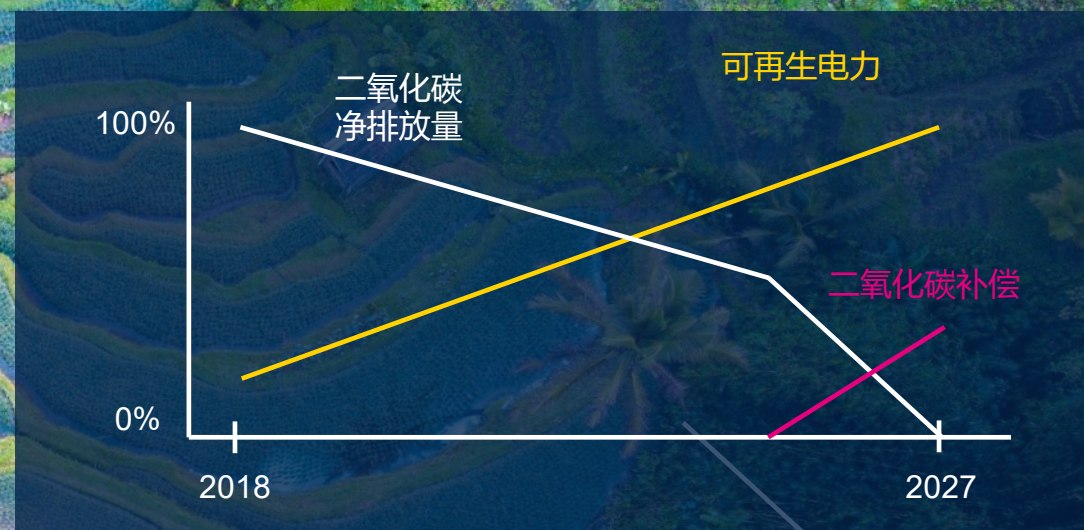


- **到 2027 年实现碳中和** (针对范围1和范围2, 范围3则聚焦于产品运输、商务旅行及员工通勤产生的排放到2027年100%使用可再生能源)
- 到2027年实现**100%可再生电力采购**
- 在整个生态系统中**建立共同实现碳中和的合作计划和伙伴关系**



2025年, 我们实现了科学目标倡议 (SBTi) 认可的两个战略里程碑:

- 与2018年相比, 范围1和2的温室气体排放量减少了50%
- 目前已实现80%的可再生电力采用率, ST将在2025年进一步采购86%的可再生电力



可持续性评级和排名 可持续性认可

我们致力于参与行业评级和基准测试活动



FTSE4Good



被《时代》杂志评选为
“全球最具可持续发展力企业”



位列全球最具可持续发展力企业第25位
荣登电子、硬件及设备类别榜首

ST的可持续发展承诺和绩效

我们的承诺		我们在2025年取得的成果	
	业内首家在2027年实现碳中和的企业		可持续分析：15.2低风险
	业内首次在2025年实现SBTi验证的减排目标（到2025年实现50%的范围1和2）		CDP：气候B/水B（非公开）*
	首家加入水资源管理联盟的IDM		Ecovadis: 白金评级
	负责任商业联盟正式成员，董事会中有ST代表		ISS ESG: 标杆企业（2026年3月）



基于意法半导体N.V.和在线公众评级
*非公开模式下的最高得分

意法半导体基金会

ST基金会致力于开发、协调和赞助用现代科学和最新技术促进人类进步的项目



- 意法半导体基金会持续致力于弥合能够接触到现代技术和无法接触到现代技术的人群之间的**数字鸿沟**。
- Digital Unify (DU) 计划于2003年启动，自成立以来已在**32**个国家培训了超过**139**万人。

2025年，超过15万名见习学生参加了基本和高级计算机技能课程，视障人士ICB4培训以及‘Tablets for Kids’课程。

st.com/st-foundation

Our technology starts with You



Find out more at www.st.com

© STMicroelectronics - All rights reserved.

ST logo is a trademark or a registered trademark of STMicroelectronics International NV or its affiliates in the EU and/or other countries.

For additional information about ST trademarks, please refer to www.st.com/trademarks.

All other product or service names are the property of their respective owners.

